

第8回

次世代電子実装システム技術講演会

2024年

11/15

金

13:00 - 15:00

会場定員

30名 KISTEC 海老名本部  
カンファレンスルーム

オンライン定員

100名

対象

当該テーマに関心のある方は  
どなたでもご参加いただけます

多様化するMore than Mooreの電子デバイスシステム  
集積技術に向けて、近年の先端実装技術の産業分野へ  
の展開、2.3D有機インターポーザ技術紹介および次世代  
実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会  
の情報を提供します。

13:00

オープニング 青柳 昌宏 卓越教授 熊本大学 半導体・デジタル研究機構 半導体部門

## 先端パッケージ向けガラスマイクロビアアブレーション

13:00-13:30 加工用高出力KrFレーザーのビーム品質向上

次世代半導体に向けて、先端パッケージ向けガラスマイクロビアアブレーション加工用高出力  
KrFレーザーのビームの開発について紹介いたします。

講師：川筋 康文氏 ギガフォトン株式会社

## 半導体フォトカソードによるパルス電子ビームを用いた

13:30-14:00 深溝構造のSEM観測

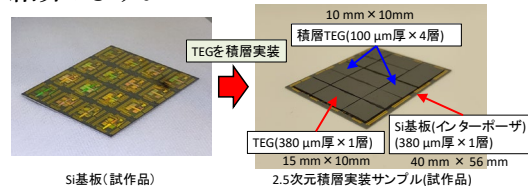
半導体フォトカソードによるパルス電子ビームを用いた深溝構造のSEM観測を紹介いたします。

講師：荒川 裕太氏 株式会社Photo electron Soul

14:00-14:30 次世代電子実装システム技術研究会の取り組みについて

次世代実装技術の産官学連携開発体制構築を目指した研究会の情報を紹介します。

根本 俊介 KISTEC 電子技術部 電子デバイスグループ



## Development of New Concept Photo Imageable Dielectric

14:30-15:00 Materials for Next-Generation Advanced Packaging

次世代先端パッケージング向けの新コンセプトのフォトイメージャブル誘電体材料の開発をご紹  
介します。

講師：佐藤 一樹氏 東京応化工業株式会社

次世代実装システム技術研究会  
<https://www.kistec.jp/inno-hub/e15-1/>

15:00

エンディング 三橋 雅彦 KISTEC 電子技術部

参加申し込みは、[KISTECのInnovationHub2024ホームページ](https://www.kistec.jp/inno-hub/2024/)  
からお申し込み下さい。  [こちらをクリックして下さい。](https://www.kistec.jp/inno-hub/2024/)



お問い合わせ：電子技術部 電子デバイスグループ 根本俊介 E-mail: [sm-electronic\\_devices\\_g@kistec.jp](mailto:sm-electronic_devices_g@kistec.jp)

主催：地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 (KISTEC)